

## 第2回冷凍部会例会（公開）

### テーマ：高温超電導機器実用化への大きな潮流

近年の低温工学及び超電導工学の分野では、航空機等への液体水素と高温超電導の応用、REBCO 線材実用化への強力な研究開発、その線材を実用機器に生かそうとする小型核融合炉開発に見られるように、より実現性の高い研究開発が推進されています。従来の超電導発電機、超電導電力送電、SMES 開発等には見られなかった、過去の例から学んだ超電導機器実用化への大きな潮流とも言えます。第2回冷凍部会例会では、フロリダ州立大学の Sastry Pamidi 教授、九州大学の木須隆暢教授、核融合科学研究所の柳長門教授にお願いし、現在我々の分野において推進されているこれらの研究開発と実用化への状況を詳しく解説していただきます。なお、Pamidi 教授のご講演は英語で行われ（質問などは日本語でも結構です）、木須教授と柳教授のご講演は日本語で依頼しております。

これまでに無い新しい企画です。是非、奮ってご参加下さい。

**日時**：2026年6月30日(火) 13:00～17:00

**会場**：川崎重工株式会社 東京本社9階会議室  
〒105-8315 東京都港区海岸1丁目14番5号

(アクセス) [https://www.khi.co.jp/corporate/network/tokyo.html?utm\\_source=copilot.com](https://www.khi.co.jp/corporate/network/tokyo.html?utm_source=copilot.com)

**参加費**：今回の例会は冷凍部会員以外も参加できる公開例会です。

冷凍部会会員*	低温工学・超電導学会会員	いずれも非会員
無料	2,000 円**	5,000 円**

\*冷凍部会会員資格は冷凍部会事業会員名簿 (<http://www.reitob.org/list/memlist.html>) をご確認ください。冷凍部会事業会員は各企業の事業場ごとの登録になっております。

\*\*支払いは PayPal 決済にて申し受けます。別途、支払用の URL をお伝えします。

#### プログラム：

- |  |   |             |
|--|---|-------------|
| 1. 開会挨拶  | 冷凍部会長   | 13:00～13:05 |
| 2. Liquid Hydrogen-Enabled Cryogenic Cooling of Superconducting Devices for Various Applications                                 | Sastry Pamidi, Professor and Chair<br>Department of Electrical and Computer Engineering<br>FAMU-FSU, USA  | 13:05～14:15 |
| 3. フュージョンエネルギーを拓く高温超伝導基盤技術の最前線<br>Frontiers of Foundational High-Temperature Superconducting Technologies Enabling Fusion Energy | 木須 隆暢 教授<br>九州大学 大学院システム情報科学研究院長<br>Prof. Takanobu Kiss<br>Dean, Graduate School and Faculty of Information Science and Electrical Engineering, Kyushu University | 14:15～15:25 |

休 憩

15:25～15:40

4. コンパクト核融合炉への適用をめざした高温超伝導マグネット開発の現状  
Current Status of Development of High-Temperature Superconducting Magnets for Compact Fusion Reactors
- 柳 長門 教授  
核融合科学研究所  
超伝導・低温工学ユニット  
Prof. Nagato Yanagi  
Applied Superconductivity and Cryogenics Unit  
National Institute for Fusion Science
- 15:40～16:50
5. 閉会挨拶
- 冷凍部会庶務幹事
- 16:50～17:00

**申込方法：**①氏名，②所属，③電話・メール，④冷凍部会員（会員・非会員），低温工学・超電導学会（会員・非会員）の区別等必要事項を明記の上，電子メールでご連絡ください。

**申込締切：**2026年6月23日（火）

**申込み／問合せ先：**E-mail：reitob-inquire-ml@aist.go.jp （担当：岩井貞憲、上岡泰晴）

以上